

UDC 621.762.5
669.295-138.8:669.781-486
620.186

抵抗焼結法で製造したB纖維-Ti複合材の 纖維-マトリックス界面

Fibre-Matrix Interface of Resistance-Sintered BFibre-Ti Composite

明智清明*・原善四郎*

Kiyoaki AKECHI and Zenshiro HARA

はじめに

抵抗焼結法で製造したB纖維-Ti複合材の機械的性質および組織について前報¹⁾で報告したのに続いて、本報ではマトリックス-纖維界面での反応層の形成における抵抗焼結条件の影響について実験的に検討した結果とその考察について報告する。

実験結果

Ti-20 vol % Bの抵抗焼結体について、マトリックス-纖維界面に垂直な線分に沿って、BおよびTiの分布をEPMA法で測定した結果の数例を図1に示す。図1-aは連続通電試料(入力101 kVAC/g、通電時間1.2秒)、図1-b,cはサイクリック通電試料(正味通電時間b:0.7秒、c:2.6秒)である。

纖維-マトリックス界面に形成される反応層の厚さはB分布値0%から100%にいたるまでの線分上距離で判定した(Tiマトリックスと纖維間に空隙ができるなどの理由でTi分布値から反応層厚を求めると過大となる)。

このようにして求めた反応層の厚さは、連続通電試料

では15 μmであり、サイクリック通電試料では短時間試料で1 μm弱、長時間試料では3 μmである。

考察

(1)顕微鏡組織観察とEPMA分析の比較:連続通電試料の破面のSEM観察ではB纖維を囲んで厚さ数10 μmの柱状晶の存在が認められた。これとEPMA分析の結果を比較すると、Ti柱状晶の基部に15 μmにわたってBが侵入していることになる。連続通電で通電時間1.6秒の場合は、光学顕微鏡観察でB纖維の直径の縮少も観察された。これはTi-B間に著しい反応を生じたことを示すものと考えられる。サイクリック通電試料において顕微鏡組織観察ではB纖維周辺のTiマトリックスにとくに変った組織の存在が認められなかったのに、EPMA分析で厚さ1~3 μmの反応層の存在が認められたことは、後者の検出精度が良かったことによるもので矛盾ではない。

(2)反応層の厚さと抵抗焼結条件との関係:反応層の厚さは上述のように連続通電の場合がサイクリック通電

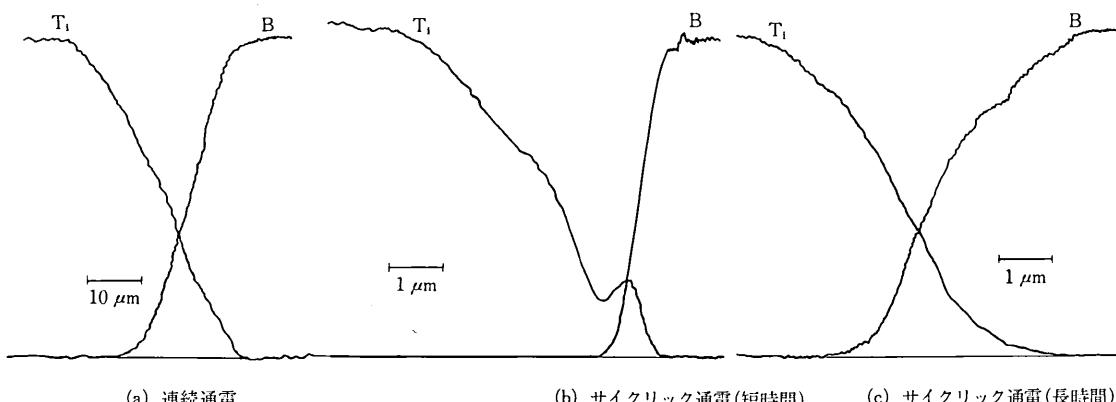


図1 抵抗焼結されたTi-20 vol % B 繊維複合材の纖維-マトリックス界面近傍のEPMAによる線分析

- (1) 連続通電、入力101 kVAc/g
- (2) サイクリック通電、正味通電時間0.7秒
- (3) サイクリック通電、正味通電時間2.6秒

* 東京大学生産技術研究所 第4部

よりも、また通電方式が同じならば通電時間の長いほうが短いときよりも、それぞれ厚くなっている。これはそれらの条件で試料がより高温に到達するためであるとして定性的には説明できるが、以下にややくわしく定量的な検討をしてみよう。

Ti-B界面での反応層形成についての研究結果²⁾によれば、反応層の成長は放物線則によるとされ、その成長速度常数が温度の関係として求められている、すなわち温度TKにおける反応層厚x cmと時間t秒の間に、

$$x = k\sqrt{t}, \quad k = 0.0501 \times 10^{-\frac{5200}{T}}$$

という関係があるといふ。

抵抗焼結中の試料の到達温度を入力および関係物質の比熱データから算出すると(ダイス・パンチへの放熱が無いものと仮定)、本例の連続通電の場合、通電時1.2, 1.4, 1.6秒における到達温度はそれぞれ1240, 1450, 1670°Cとなる。そこで抵抗焼結操作中の昇温、冷却過程を0.1秒ずつに区切り、上式を用いて生成反応層の厚さを算出すると表1のようになる(冷却過程は試料表面温度実測例³⁾から類推した)。いずれの場合も、反応層の厚さは数μm以下と算出され、実測値の15~25μmにははるかに及ばない。

このような差が表われた原因としては試料到達温度が上述の推定温度より高かったことが考えられる。事実、顕微鏡組織におけるB繊維を囲む柱状晶の存在は、B繊維の周辺温度がTiの融点(1760°C)以上に達したことを見ている。このようなB繊維周辺の温度上昇の要因としては、Ti-B間の反応熱の発生、Ti-B間の接触抵抗発熱、生成化合物層の低電気抵抗率(TiB₂: 15.2Ω·cm⁴⁾, Ti: 62 μΩ·cm)による発熱などが考えられる。TiB₂の生成熱(70 kcal/mole⁵⁾)から、Ti-20vol% B複合材中のB繊維(直径200μm)にTiB₂層が生成するときの試料(27g)の温度上昇を概算するとTiB₂層1μmあたりに9.38°Cとなる。

以上の点を考慮すると、連続通電の場合、入力のほかにTi-B間の反応発熱などが加わって、B繊維周辺の温

表1 反応層厚さの実測値と反応速度式による計算値

通電時間 (sec)	入力 (kVA C/g)	推定 到達 温度 (°C)	EPMAで実 測した反応 層厚さ (μm)	通電停止 直後の反 応層厚さ の計算値 (μm)	通電停止後 の冷却過程も考 慮に入れたと きの反応層厚 さの計算値 (μm)
1.2	101	1240	~15	0.11	0.17
1.4	120	1450	-	0.36	0.66
1.6	149	1670	~25	0.93	2.41

※連続通電、設定電流実効値58%, Ti-20vol% Bの場合

度が急速に上昇し、それが反応を促進し、けっきょく、Ti-B間の反応が加速度的に進行したものと考えられる。

(3)反応層の厚さと機械的性質との関係: 前報¹⁾で述べたように連続通電方式で製造したTi-20 vol % B複合材の引張強さは、サイクリック通電方式で製造した同密度比の複合材よりもはるかに劣っていた。そして本報で見たように前者のTi-B界面反応層の厚さは、後者の場合の約10倍程度である。このことからTi-B界面の反応層が厚すぎると複合材の機械的性質が劣化するといふことができる。

この結論は、Ti-B系FRMにおいて、B繊維が強化の役割を果たすためには反応層の厚さが臨界厚さ⁶⁾0.4μm以下でなくてはならない⁷⁾という他の研究結果と類似している。

しかし繊維強化複合材における繊維-マトリックス界面の反応層と複合材の強度の関係については、ある程度の厚さをもった反応層の存在が繊維強化の効果を示す例⁸⁾も知られており、なお一層の検討を要する。

結論

本報および前報の、抵抗焼結法によるTi-B繊維複合材の製造に関する研究結果をまとめるのつきのようになる。

(1)サイクリック通電方式は連続通電方式にくらべてTi-B界面における反応層の成長を抑制できる。

(2)Ti-B繊維複合材において、Ti-B界面の反応層の厚さが大きいときは、複合材の引張強さは低下する。

(3)最適条件で製造したTi-B繊維抵抗焼結体の高温引張強さは純Ti抵抗焼結機よりも高く、室温引張強さにおいても繊維強化の効果が認められた。

(1978年8月16日受理)

文獻

- 明智清明、原善四郎: 生産研究, 30(1978) 399, 428.
- R. Naslain, J. Thebault, R. Pailler: Proceedings of the 1975 International Conference on Composite Materials, 1, AIME New York(1975) 116.
- 明智清明、原善四郎、坂井敏郎、板橋正雄: 粉体および粉末冶金, 25(1978) 219.
- 金属データ・ブック、日本金属学会編、丸善(1974) 126.
- Г. В. Самсонов: Шугоптакие соединения, Москва(1963) 81.
- A. G. Metcalfe: J. Composite Materials, 1(1967) 356.
- G. K. Schmitz, M. J. Klein, M. L. Reid, A. G. Metcalfe: Air Force Material Laboratory Report AFMLTR-70-237 (Sept. 1970).
- J. Kennedy, G. Geschwind: Proc. Intern. Conf. Titanium, Sci. Technol. 2nd, Mass. Inst. Technol. 4(1973) 2299.